
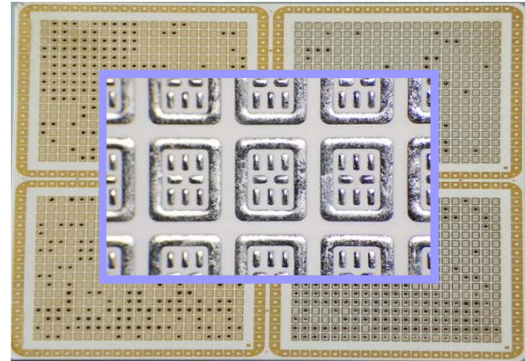


【展示No.】	【提案技術・提案製品名】	【提案区分】
45	薄膜成形技術の提案	表面処理
【会社名】	【所在地】	
株式会社 ソーデナガノ	長野県岡谷市長地片間町2-5-21	
【主要取引先】	【認証取得等】	
Nidec・, Hitachi・(株)ムラキ・シチズンファインテックミヨタ(株)	ISO9001・ISO14001	
資本金	80百万円	従業員数 115名

【提案内容】

【適用又は応用可能分野】	【提案技術のポイント】
電気・電子	多種ロー剤（Au/Sn系・鉛フリー系等）を使用した微細形状（固体・集合体）への薄膜（2μ～10μ）成形技術の提案
従来	新技術・新システム・新製品
<p>薄膜成形技術は電子デバイスのコア技術として欠かすことの出来ない分野であり、現在は製品の微細化に伴い、金属・セラミック・シリコンウエファー素材等への個体形状・集合形状への薄膜成形技術が求められている。またこの領域は既存工法が希薄な領域でありCOST的にも割高な工法に偏っている。</p> <p>弊社は独自の印刷工法を開発し、Au/Sn合金を用いて水晶振動子・SAWフィルター分野のLID（パッケージの蓋）を業界に提供している。</p>	<p>LID製造技術の応用として、薄膜成形技術を提案する。提案の工法は従来のスパッタ法・積層メッキ法などの工法を凌駕できる工法である。本工法は印刷工法を基本とし、日常の生産活動で培ってきた技術・知恵・勘所を数値化高度化・標準化することにより低コスト及び工程の短縮が推進でき、優れた品質が維持できる。</p>
 <p>弊社・製造LIDサンプル</p>	 <p>(例) セラ基板への薄膜成形</p>

【提案新技術における問題点（課題）と対応方法】

具体的開発テーマとのマッチング

【開発進捗】 平成22年10月 現在

アイデア段階 試作/実験段階 開発完了段階 製品化完了段階

【特許】 有

従来との比較	項目	コスト	質量	生産性/作業性	品質/性能	環境配慮	その他()
数値割合		20% 低減	0% 低減	20% 向上	0% 向上	0% 向上	

連絡先	【担当部署】	【担当者】	URL : http://www.soode.co.jp
	電子部品事業部	八幡 兵吉	電話 : 0266-26-3760
			e-mail : yawata@soode.co.jp